

LPFS

レーザー加工管理技術者認証基準

Standard for certification of laser processing coordination
personnel

LPFS 1001 : 2011

平成 23 年 2 月 17 日 制定

一般社団法人レーザープラットフォーム協議会

一般社団法人レーザープラットフォーム協議会規格

レーザー加工管理技術者認証基準

Standard for certification of laser processing coordination personnel

序文 要求する品質を満足し、安全な製品を製作するためには、レーザー加工に関する必要かつ十分な知識、職務能力及び経験を有するレーザー加工管理技術者の管理のもとで、レーザー加工管理技術者の任務及び責任により、設計、施工計画、施工基準、検査基準などが決定され、適正な施工が行われなければならない。

一方、溶接全般については、社団法人日本溶接協会は溶接管理技術者を認証することを目的として、1970年に日本溶接協会規格 WES 8103（溶接管理技術者認証基準）を制定し、溶接管理技術者の認証を実施している。

この規格は、日本溶接協会規格 WES 8103（溶接管理技術者認証基準）を参考にして、レーザー加工管理技術者に限定した認証基準を規定したものである。

1. 適用範囲

この規格は、一般社団法人レーザープラットフォーム協議会（以下、協議会という。）がものづくりを対象にしたレーザー加工管理技術者を認証するための認証基準について規定する。

2. 参考規格

日本溶接協会規格 WES 8103（溶接管理技術者認証基準）

3. 定義

この規格で用いる主な用語の定義は、次による。

- a) **適格性** レーザ加工管理技術者の知識、職務能力及び経験がこの規格に適合していること
- b) **協議会** 一般社団法人レーザープラットフォーム協議会
- c) **認証** 適格性について審査及び評価試験を実施し、合格した者に対して協議会が証明すること
- d) **適格性証明書** 認証されたレーザー加工管理技術者へ協議会が交付する文書
- e) **申請者** 認証を求めて申請する者
- f) **登録者** 評価試験に合格し登録されたレーザー加工管理技術者
- g) **サーベイランス** 登録者が引き続きこの規格に適合していることを、登録者から提出された文書で協議会が確認すること
- h) **再認証** 登録者が所定の再認証の審査に合格し、認証の有効期間終了後も引続き認証されること
- i) **クレジット・システム** 付属書（参考）に定めるポイントの獲得数が、申請時期をさかのぼる所定の年数以内に、所定のポイント以上であることを証明できる者は、認証又は再認証の際に評価試験の免除を受けることができるシステム

4. レーザ加工管理技術者の認証等級

4.1 レーザ加工管理技術者の認証等級（以下、等級という。）は、この規格に定める審査及び評価試験により決定する。

4.2 等級は、レーザー加工管理技術者の任務及び責任、知識及び職務能力に基づいてそれぞれ1級及び2級とする（表1参照）。

表1 レーザ加工管理技術者の任務及び責任並びに知識及び職務能力

等級	任務及び責任	知識及び職務能力
1 級	次の事項を実施し、レーザ加工に関する総括的な責任を負う技術者 a) レーザ加工仕様書の確定及びレーザ加工手順書の承認 b) 作業記録及び成績書等の承認	レーザ加工技術に関する包括的技術知識及び施工、管理などに関する統括職務能力
2 級	次の事項を実施し、業務遂行のため監督・指導を行う技術者 a) レーザ加工仕様書の確認及びレーザ加工手順書の作成 b) レーザ加工技能者の監督・指導 c) 設備及び機器の点検・校正	レーザ加工技術に関する技術知識及び施工に関する職務能力

5. 受験条件及び受験条件の審査

5.1 受験条件 申請者は、表2 に示す条件に該当する職務経験を有していなければならない。

表2 受験条件

学歴又は認証	等級別の必要職務経験年数	
	1 級	2 級
① 大学院卒業者（理工系）	1	1
② 大学院卒業者（理工系以外）	3	1
③ 大学卒業者（理工系）	2	1
④ 大学卒業者（理工系以外）	4	2
⑤ 短期大学卒業者（理工系）	4	1
⑥ 短期大学卒業者（理工系以外）	7	4
⑦ 工業高等専門学校卒業者	4	1
⑧ 理工系各種専門学校卒業者	6	2
⑨ 工業高等学校卒業者（工業高校）	7	2
⑩ 工業高等学校以外の高等学校卒業者	8	4
⑪ 上記学歴によらない場合	11	7

備考

1. 表中の経験年数は、最小限の必要年数を表す。
2. 経験年数は、レーザ加工技術に関連した職務に専従した期間とし、専従でない場合は職務の実態に応じて査定する。
3. 経験年数は、卒業後の年数とする。
4. ③の大学卒業者（理工系）は、工業高等専門学校専攻科卒業者を含む。
5. ⑧の理工系各種専門学校卒業者は、高等学校卒業以上の学歴を有している場合に認められる。

5.2 受験条件の審査 協議会は、申請者からの申請書類に基づき、申請者が受験条件に適合していること書類審査を行う。この書類審査には、6.2の規定による筆記試験及び口述試験の免除の審査も含まれる。

6. 評価試験

6.1 試験の内容 協議会は、レーザ加工に関する任務及び責任を遂行する知識及び職務能力を確認する試験を実施する。試験は、筆記試験及び口述試験とする。

6.2 筆記試験及び口述試験の免除

筆記試験及び口述試験の免除は、次のとおりである。

- a) レーザ加工管理技術者の認証に適切であると協議会が予め認めた研修会などに出席し、所定課目の修了証書を取得した者は、6.1の規定にかかわらず口述試験を免除することができる。
- b) 筆記試験及び口述試験の代替として、クレジット・システムを適用し、原則として、申請時期をさかのぼる5年(60か月)以内に、1級レーザ加工管理技術者においては54ポイント以上、2級レーザ加工管理技術者においては27ポイント以上獲得したことを証明できる者は、認証又は再認証の際に6.1の規定にかかわらず筆記試験及び口述試験を免除することができる。

ただし、申請された受験条件を審査した結果、書類審査のみでは適格性を評価できないと判断された場合は、筆記試験及び口述試験を免除しない。

7. 合否判定基準

次のa)及びb)をともに満足する者を合格とする。

- a) 筆記試験で所定の点数以上の点数を得ていること。
- b) 口述試験を実施した場合、十分な知識及び職務能力を有すると認められること。

8. 登録期間及び適格性証明書

8.1 登録期間 認証の登録期間は、5年とする。

8.2 適格性証明書の交付 協議会は、評価試験に合格し、所定の手続きを完了した申請者へ適格性証明書(以下、証明書という。)を交付する。

8.3 証明書の有効期間 証明書の最初の有効期間は、2年とする。この有効期間内に8.4に規定するサーベイランスを受け、適格性が維持されていることが確認された場合、新たな証明書の有効期間は残りの登録期間とする。

8.4 サーベイランス 証明書の有効期間満了前6か月以内に、登録者からの申請により協議会は、サーベイランスを行う。サーベイランスは業務従事証明を確認することにより行い、必要と認められる場合には面接などで確認する。

8.5 証明書の失効 証明書は、有効期間を過ぎた場合、その効力を失う。

9. 認証の失効

次のいずれかに相当する場合、認証は失効する。

- a) 証明書の有効期間が満了した場合。
- b) 申請から認証までの全過程における不正行為、認証後の証明書の故意による誤使用、業務上の不正行為、重大な過失に起因する苦情などがあり、協議会が証明書の取消が相当と認めた場合。

10. 再認証

10.1 登録者は、8.3に定める有効期間満了前1年以内に、かつ認証が失効する前に、再認証審査を受けることができる。

10.2 再認証の審査は、次のa)及びb)により行う。

- a) 再認証審査申請書に基づく書類審査
- b) 評価試験

上記a)の審査及びb)の評価試験の結果、協議会が必要と認めた場合には二次審査を追加する。二次審査の要領については別に定める。

10.3 前項10.2b)の評価試験の代替として、クレジット・システムを適用できる。

10.4 前項10.2・10.3の書類審査/評価試験に合格した場合は、指定された期日までに所定の手続きを行うことで、登録期間満了に続いて新たに認証されたものとして登録する。

附属書（参考）クレジット・システム

序文 この附属書（参考）は、レーザ加工管理技術者の認証又は再認証において構築されたクレジット・システムについて記述したものであり、規定の一部ではない。

1. 適用範囲

この附属書（参考）は、レーザ加工管理技術者の認証又は再認証に適用する。

2. 申請

クレジット・システムの適用を希望する申請者は、認証又は再認証申請書のほか、次表で定めるポイントに関する証明書類を提出しなければならない。

3. 審査及び結果の通知

レーザ加工管理技術者認証委員会（以下、委員会という。）は、提出された書類に基づいて、クレジット・システム適用の妥当性を審査し、その結果を申請者に通知する。

必要な場合は、電話、面談等による調査や確認を行うことがある。

5. 異議申立て

前項の審査結果に異議のある者は、その理由を付した上、異議を申し立てることができる。

表：認証又は再認証についてのクレジット・システム

活動	ポイント
1. レーザ加工及び関連する技術 ^{注1)} に関する学・協会及び教育・研究機関等が主催する研修会，講習会，研究委員会，検討会，学術発表会等において，講師又は座長を務めた者。	1 時間 ^{注2)} あたり 3
2. レーザ加工及び関連する団体の発行する書籍，定期刊行物等への，依頼による執筆，又はレビューを伴う論文の投稿 ^{注3)} ， ^{注6)} 。	1 件あたり 18
3. 前記 1 項に該当する会合に，発表論文等を提出又は発表を行った場合 ^{注3)} ， ^{注6)} 。	1 件あたり 12
4. 前記 1 項に該当する会合に出席した場合 ^{注3)} 。	1 時間 ^{注2)} あたり 1
5. 外部団体及び外部企業 ^{注7)} に対して，レーザ加工及び関連する技術 ^{注1)} に関するコンサルタントを行った場合。（業務の一環として行っている内容は除く。）	1 時間 ^{注2)} ， ^{注4)} あたり 1
6. その他，レーザ加工及び関連する技術 ^{注1)} への社会的貢献又は第三者への貢献，並びに自己研鑽に寄与したと自他ともに認められる活動で，いずれも第三者による証明が可能なもの。レーザ加工及び関連する技術 ^{注1)} に関する外部団体等からの表彰，規格化・標準化への貢献あるいは学・協会等への貢献等 ^{注5)} ， ^{注6)} 。	別に定める ^{注5)}

注 1) レーザ加工及び関連する技術とは，レーザ加工管理技術者に要求される技術分野に限定される。

注 2) 正味 45 分を 1 時間とカウントしてよい。

注 3) 2 項において，レビューを伴わない論文投稿，あるいは自主投稿による場合は，3 項のポイントが適用される。

注 4) コンサルタント業務には，調査・準備等の時間を含めることができるが，旅行・移動等の時間を含めることはできない。

注 5) 6 項の審査については，委員会が内容の妥当性評価を行い，必要により証明書類等の提出を求め，ポイントを決定し総合評価する。社会的貢献には，レーザ加工業界に有益な特許の成立が含まれる。

注 6) 著作物，論文等が共著の場合，少なくとも 10%の貢献がなければカウントされない。特許や表彰が複数による場合も同様に，少なくとも 10%の貢献がなければカウントされない。

注 7) グループ企業は除く。